

LMP シンポジウム 2015

「レーザ加工技術の最新動向と基礎」

開催日 : 平成 27 年 2 月 23 日 (月) ~ 2 月 24 日 (火)
開催場所 : 新横浜国際ホテル マナーハウス南館 2 階チャートル

主 催

一般社団法人 日本溶接協会

企 画

レーザ加工技術研究委員会 (LMP 委員会)

(Laser Materials Processing Committee)

協 賛

- | | |
|----------------|-------------------|
| ◆一般社団法人溶接学会 | ◆一般社団法人レーザ加工学会 |
| ◆一般社団法人日本鉄鋼協会 | ◆一般社団法人スマートプロセス学会 |
| ◆一般社団法人軽金属溶接協会 | ◆一般社団法人日本チタン協会 |
| ◆中部レーザ応用技術研究会 | ◆一般社団法人レーザー学会 |
| ◆レーザ協会 | ◆ステンレス協会 |
| ◆産報出版(株) | (順不同、依頼中含む) |

〔 開 催 主 旨 〕

近年、レーザ発振器とその周辺の光学系、ロボット、加工装置などの発展はめざましく、溶接、切断、マーキング、微細加工など各種レーザ加工技術の実用化が着実に進んでいます。日本溶接協会 LMP 委員会では、レーザ加工の実用化を念頭に、高出力のレーザ発振器および周辺機器、レーザ加工技術の研究開発・実適用に関する現状と今後の展開といった最新の話題について、2001 年より年 1 回のレーザ加工シンポジウムを開催して参りました。

今年度は、「レーザ加工技術の最新動向と基礎」と題して、レーザ加工に関する知識・経験が十分ではない方々に基礎から理解を深めていただくとともに、レーザ加工のエキスパートである方々に興味を持っていただける最新技術動向を紹介するような構成としました。1 日目には、LMP 委員会の活動として 2013 年に制定されたレーザ溶接用語の JIS、ならびに近年目覚ましい発展を見せている中国のレーザ加工技術動向の調査結果を紹介するほか、レーザ溶接および切断の基礎を解説し、高出力および短波長といった特徴的なレーザ溶接プロセスに関する最新技術を各分野の第一人者の方々に講演していただきます。2 日目には、レーザ照射による表面加工・熱処理技術、溶接・切断用レーザシステム、光学系などのレーザ加工機器に関する最新技術の講演を、それぞれ著名な専門家に講演していただきます。また、2 日目午後には見学会として、レーザ発振器および加工機器の最大手であるトルンプ株式会社の協力を得て、レーザ発振器製造ラインおよびショールームでのレーザ加工実演をご覧いただく予定です。

この貴重な機会をご利用いただき、今後益々発展するレーザ溶接・レーザ加工の導入検討あるいはさらなる新技術開発の一助としていただければと思います、ここにご案内申し上げます。

第1日目：2月23日（月）

10:30～10:40	開会の挨拶	LMP 委員会委員長 杓名 宗春 氏
セッション1【LMP 委員会の活動紹介】		司会：山岡 弘人（(株)IHI）
10:40～11:10	JISZ3001-5「溶接用語－レーザー溶接」の解説	JFE スチール(株) 木谷 靖 氏（LMP 委員会幹事長）
11:10～12:00	中国におけるレーザー加工の最新動向	LMP 委員会 中国レーザー加工動向調査団
12:00～13:00	昼 食 休 憩	
セッション2【レーザー加工の基礎】		司会：木谷 靖（JFE スチール(株)）
13:00～13:40	レーザー溶接の基礎	大阪大学接合科学研究所 片山 聖二 氏
13:40～14:20	レーザー切断の基礎と実施例	小池酸素工業(株) 大森 工 氏
14:20～14:35	休 憩	
セッション3【最新レーザー溶接技術】		司会：多羅沢 湘（日立 GE ニュークリア・エナジー(株)）
14:35～15:15	船体建造工程におけるレーザー・アークハイブリッド溶接技術の適用に向けた基礎検討	九州大学 後藤 浩二 氏
15:15～15:55	100kW ファイバーレーザー溶接の基礎研究	(株)ナ・デックスプロダクツ 住森 大地 氏
15:55～16:35	レーザー溶接モニタリング技術	丸文(株) 江嶋 亮 氏
16:35～17:15	短波長レーザーを用いた難溶接材の溶接特性について	(株)日立製作所 張 旭東 氏

第2日目：2月24日（火）

セッション4【最新レーザー表面加工技術】		司会：柴田 公博（仙台大専）
9:00～ 9:40	レーザーピーニング技術の開発とその応用	(株)最新レーザー技術研究センター 杓名 宗春 氏
9:40～10:20	高出力LDによる金属表面焼入れ、熱処理	エンシュウ(株) 原田 裕文 氏
10:20～10:35	休 憩	
セッション5【最新レーザー加工機器】		司会：内藤 恭章（新日鐵住金(株)）
10:35～11:15	高出力ダイレクトダイオードレーザー搭載リモートレーザー溶接ロボットシステム	パナソニック溶接システム(株) 西村 仁志 氏
11:15～11:55	ファイバーレーザーの最新技術と動向	IPG フォトニクスジャパン(株) 伊藤 亨 氏
11:55～12:35	レーザー加工用光学系	住友電工ハードメタル(株) 亀田 信治 氏
12:35～12:40	閉会の挨拶と見学会説明	LMP 委員会副委員長 山岡 弘人 氏
12:40～13:40	昼 食 休 憩	
見学会【トルンプ株式会社レーザー発振器工場・レーザー加工実演】（希望者のみ）		
13:40～17:00	13:40新横浜国際ホテル発（チャーターバス移動）→14:00トルンプ(株) ①トルンプレーザー発振器、レーザー加工機製品紹介 ②レーザー発振器製造ライン見学 ③ショールームでのレーザー加工実演見学 17:00トルンプ(株)発（チャーターバス移動）→JR新横浜駅→JR横浜駅	

※ 開場および受付開始時間は、両日とも講演開始時間の 30 分前とします。

見学会に参加されない方は、12:40 講演終了時に新横浜国際ホテルで解散とします。

見学会に参加される方は、見学会後 JR 新横浜駅、JR 横浜駅のいずれかでバス下車、解散とします。

講師およびスケジュールについては、やむを得ない事情により変更になる場合があります。

同業他社の方は見学をご遠慮いただく場合がございます。何卒ご理解下さい。

最新情報はホームページにてご確認ください。 <http://www.jwes.or.jp/lmp/>

〔 開 催 要 領 〕

1. 日 時

平成 27 年 2 月 23 日(月) (講演会 1 日目) 10:30~17:15

平成 27 年 2 月 24 日(火) (講演会 2 日目) 9:00~12:40

(見学会) 13:40~17:00

2. 定 員

100 名

※申込み先着順とし、定員になり次第締め切らせていただきます。

3. 参加料 (テキスト代・消費税を含む)

参加日数	会 員※	非会員
2 日間	20,000 円	30,000 円
1 日のみ	15,000 円	20,000 円

※会員とは、日本溶接協会団体会員会社 (<http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp> 参照) です。

4. 申込み締切日

平成 27 年 2 月 9 日 (月) (ただし、定員になり次第締め切り)

5. 申込要領ほか

- ・添付の参加申込書にご記入の上、FAX にて講習会事務局までご送付下さい。
- ・申込受付後、FAX にて受講券をお送り致します。当日必ずご持参下さい。
- ・参加料は受講券受領後、次の方法でご送金下さい。(銀行振込手数料は各自ご負担下さい。)

銀行振込： 三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No. 146921 (社)日本溶接協会

(原則として、銀行口座への振込みをもって領収に代えさせていただきますのでご了承下さい。)

- ・原則として振込み後の参加料は返却致しません。欠席の場合は、代理出席をお願い致します。
- ・テキストは、当日会場受付でお渡し致します。
- ・昼食は、両日とも各自で会場近隣の飲食店などをご利用下さい。
- ・宿泊は各自適宜ご手配ください。会場となる新横浜国際ホテルでのご宿泊は、ホテルのホームページ (<http://sinyokohama.khgrp.co.jp/index.html>) からご予約下さい。

6. 講習会事務局

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 4-20 (一社)日本溶接協会 業務部 上原

TEL : 03-5823-6324 FAX : 03-5823-5244

7. 会場

会場：新横浜国際ホテル マナーハウス南館 2 階チャータール

住所：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 3-18-1

TEL : 045-473-1311 (代表)

アクセス：



【JRをご利用の場合】 JR 新横浜駅・北口より徒歩 3 分（上図 A～F の順路）

【横浜市営地下鉄をご利用の場合】 新横浜駅・7 番出口より徒歩 1 分。

※会場へのお車でのご来場はなるべくご遠慮下さい。